

護銅劑WPF-21

簡介：

各種各樣的防護方法被使用為印製電路板銅箔的保護。然而，其主要的用途在於含有樹酯的有機溶液和錫焊劑互相融合、可以嚴密地被控制。今後，還需要面對環境污染的問題。但是，以往所使用的舊產品之用途被限制了，由於它的鍍錫密合接著性和鍍金變色部分的問題。當 WPF-21 被使用於電路板鍍金部分，具有優秀的鍍錫的密合接著性。所以，現在被開發應付於鍍金部分的變色的問題。

特徵：

可以有效防止化金部份變色。

可以在銅箔表面形成耐熱、耐濕的有機膜。

較諸以往的水溶性助焊液，耐熱性更加優異，經複數次迴焊處理後仍可展現極佳的焊接性。

具有極高的焊錫擴散性。

對無鉛錫膏的流（波）焊性有助益。

只要浸泡 60~90 秒鐘，即可形成皮膜。

所形成的皮膜既薄又均勻，可使銅箔焊電表面平滑，最適合使用於高密度組裝的基板。

不含有機溶劑，所以不怕會引火。

規格：

外觀：微白色透明液狀

比重：1.03±0.01（20℃）

酸鹼值：3.30±0.3（20℃）

酸價：125±20

有效成分濃度：100±10%